



2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2023年10月26日

上場取引所 東

上場会社名 新光電気工業株式会社

コード番号 6967 URL <https://www.shinko.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 倉嶋 進

問合せ先責任者 (役職名) 経営企画室長 (氏名) 清野 貴博 TEL 026-283-1000

四半期報告書提出予定日 2023年11月13日 配当支払開始予定日 2023年11月29日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2024年3月期第2四半期の連結業績(2023年4月1日~2023年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年3月期第2四半期	105,109	△33.1	11,470	△77.5	14,073	△74.2	9,780	△74.2
2023年3月期第2四半期	157,005	24.7	50,952	69.5	54,649	73.2	37,873	74.4

(注) 包括利益 2024年3月期第2四半期 10,843百万円(△72.3%) 2023年3月期第2四半期 39,200百万円(78.8%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年3月期第2四半期	72.39	—
2023年3月期第2四半期	280.34	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2024年3月期第2四半期	389,575	258,541	66.4
2023年3月期	386,934	251,014	64.9

(参考) 自己資本 2024年3月期第2四半期 258,541百万円 2023年3月期 251,014百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年3月期	—	25.00	—	25.00	50.00
2024年3月期	—	25.00	—	—	—
2024年3月期(予想)	—	—	—	25.00	50.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2024年3月期の連結業績予想(2023年4月1日~2024年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通 期	230,000	△19.7	35,000	△54.4	35,000	△55.6	24,000	△56.0	177.63

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	2024年3月期2Q	135,171,942株	2023年3月期	135,171,942株
② 期末自己株式数	2024年3月期2Q	54,430株	2023年3月期	65,449株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2024年3月期2Q	135,110,828株	2023年3月期2Q	135,096,478株

※四半期決算短信は公認会計士または監査法人の四半期レビューの対象外です。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。

実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

なお、業績予想に関する事項は、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご参照ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表および主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(セグメント情報)	9
参考資料	11

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間(2023年4月1日～2023年9月30日)の半導体業界は、需要減少の底打ちが見られるものの、世界的なインフレの継続や米中対立の影響に加え、コロナ特需の反動によるパソコン・サーバー市場の落ち込みや、買い替えサイクル長期化等によるスマートフォン需要の減少、在庫調整などにより、市況回復が遅れ、厳しい環境が継続しました。

このような環境下にあつて、当社グループにおきましては、フリップチップタイプパッケージは、パソコン・サーバー需要の回復の遅れ等により売上が大きく減少しました。リードフレームは在庫調整の影響を受け、半導体製造装置向けセラミック静電チャックは半導体輸出規制に加え、市況悪化を背景に減収となりました。また、IC組立についてもハイエンドスマートフォン向けの需要が減少するなど、総じて市況低迷の影響を受けました。

これらの結果、当第2四半期までの累計で売上高は1,051億9百万円(前年同期比33.1%減)となりました。利益面につきましては、売上高減少の影響を大きく受け、経常利益は140億73百万円(前年同期比74.2%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は97億80百万円(同74.2%減)となりました。

セグメント別の状況は次のとおりであります。

プラスチックパッケージ

フリップチップタイプパッケージは、コロナ特需の反動などによるパソコン・サーバー需要の回復の遅れ等により、大幅な減収となりました。IC組立はスマートフォン市場の低迷によりハイエンドスマートフォン向けの需要が減少し、プラスチックBGA基板は先端メモリー向けが在庫調整の影響を受けるなど、売上がそれぞれ減少しました。

これらの結果、当セグメントの売上高は654億6百万円(前年同期比31.6%減)、経常利益は71億48百万円(同79.2%減)となりました。

メタルパッケージ

リードフレームは、半導体市況低迷による在庫調整等の影響を大きく受け、半導体製造装置向けセラミック静電チャックは、米中対立による半導体輸出規制の影響やメモリー市況悪化などを背景として、それぞれ大幅な減収となりました。また、CPU向けヒートスプレッダーは、パソコン需要減退等の影響を受け、ガラス端子は光学機器向けが低調に推移し、それぞれ売上が減少しました。

これらの結果、当セグメントの売上高は354億6百万円(前年同期比36.5%減)、経常利益は79億74百万円(同60.5%減)となりました。

なお、上記のセグメント別の売上高は外部顧客への売上高であり、経常利益はセグメント間取引調整前のものです。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期末の財政状態につきましては、前連結会計年度末に比べ総資産が26億41百万円増加し3,895億75百万円となりました。負債は48億85百万円減少し1,310億34百万円となりました。純資産は75億27百万円増加し2,585億41百万円となりました。この結果、自己資本比率は66.4%となりました。

(キャッシュ・フローの状況)

当第2四半期までの累計で、営業活動の結果得られた資金は241億86百万円となりました。また、

投資活動の結果使用した資金は 389 億 59 百万円となりました。財務活動の結果使用した資金は 34 億 30 百万円となりました。

これらの活動の結果に為替換算差額を加味した当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ 168 億 11 百万円減少し 987 億 80 百万円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2024年3月期通期の連結業績予想につきましては、2023年10月20日に発表いたしました業績予想数値から変更しておりません。

2. 四半期連結財務諸表および主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	116,325	99,669
受取手形、売掛金及び契約資産	62,356	60,420
商品及び製品	10,397	7,128
仕掛品	13,755	13,806
原材料及び貯蔵品	11,014	8,300
その他	12,231	11,351
貸倒引当金	△6	△6
流動資産合計	226,075	200,670
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	37,885	49,521
機械装置及び運搬具（純額）	45,434	41,928
工具、器具及び備品（純額）	3,184	3,561
土地	7,687	7,892
建設仮勘定	59,876	79,353
有形固定資産合計	154,068	182,257
無形固定資産	876	999
投資その他の資産		
投資有価証券	48	51
退職給付に係る資産	2,005	2,106
繰延税金資産	3,446	3,050
その他	419	445
貸倒引当金	△8	△7
投資その他の資産合計	5,912	5,647
固定資産合計	160,858	188,904
資産合計	386,934	389,575

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	24,565	26,891
短期借入金	30,000	30,000
未払金	13,483	16,325
未払法人税等	12,073	3,654
未払費用	10,245	10,350
契約負債	41,535	39,140
その他	1,642	2,396
流動負債合計	133,545	128,758
固定負債		
退職給付に係る負債	1,847	1,856
その他	526	420
固定負債合計	2,374	2,276
負債合計	135,919	131,034
純資産の部		
株主資本		
資本金	24,223	24,223
資本剰余金	24,173	24,222
利益剰余金	203,882	210,285
自己株式	△74	△61
株主資本合計	252,205	258,668
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1	2
繰延ヘッジ損益	14	△60
為替換算調整勘定	△612	384
退職給付に係る調整累計額	△594	△454
その他の包括利益累計額合計	△1,190	△127
純資産合計	251,014	258,541
負債純資産合計	386,934	389,575

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
売上高	157,005	105,109
売上原価	98,349	86,639
売上総利益	58,656	18,469
販売費及び一般管理費	7,703	6,998
営業利益	50,952	11,470
営業外収益		
受取利息	115	358
受取補償金	45	599
為替差益	3,458	1,451
その他	113	239
営業外収益合計	3,733	2,648
営業外費用		
支払利息	32	33
その他	4	12
営業外費用合計	36	46
経常利益	54,649	14,073
特別損失		
固定資産除却損	627	628
特別損失合計	627	628
税金等調整前四半期純利益	54,022	13,444
法人税、住民税及び事業税	16,054	3,338
法人税等調整額	94	325
法人税等合計	16,149	3,664
四半期純利益	37,873	9,780
親会社株主に帰属する四半期純利益	37,873	9,780

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
四半期純利益	37,873	9,780
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△0	1
繰延ヘッジ損益	60	△74
為替換算調整勘定	1,140	996
退職給付に係る調整額	126	139
その他の包括利益合計	1,327	1,063
四半期包括利益	39,200	10,843
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	39,200	10,843
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	54,022	13,444
減価償却費	16,248	12,928
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△185	△91
受取利息及び受取配当金	△119	△362
支払利息	32	33
為替差損益 (△は益)	△604	△429
有形固定資産除却損	627	628
売上債権の増減額 (△は増加)	△2,635	3,245
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△7,382	6,068
仕入債務の増減額 (△は減少)	△3,747	798
未払費用の増減額 (△は減少)	△281	44
契約負債の増減額 (△は減少)	25,493	△2,395
その他	△4,794	1,366
小計	76,673	35,279
利息及び配当金の受取額	119	365
利息の支払額	△32	△33
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△18,897	△11,424
営業活動によるキャッシュ・フロー	57,862	24,186
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△665	△778
定期預金の払戻による収入	395	675
有形固定資産の取得による支出	△30,274	△38,197
無形固定資産の取得による支出	△138	△230
その他	△612	△427
投資活動によるキャッシュ・フロー	△31,296	△38,959
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	△3,714	△3,377
その他	△48	△52
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,763	△3,430
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,839	1,390
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	24,641	△16,811
現金及び現金同等物の期首残高	68,758	115,592
現金及び現金同等物の四半期末残高	93,399	98,780

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前題に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)

報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報ならびに収益の分解情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 3
	プラスチック パッケージ	メタル パッケージ	計				
売上高							
一時点で移転される財	95,604	55,793	151,397	5,607	157,005	—	157,005
一定の期間にわたり移 転される財	—	—	—	—	—	—	—
I Cリードフレーム	—	24,906	24,906	3,615	28,522	—	28,522
I Cパッケージ	95,604	7,703	103,307	83	103,391	—	103,391
気密部品	—	23,183	23,183	1,895	25,078	—	25,078
その他	—	—	—	12	12	—	12
顧客との契約から生じ る収益	95,604	55,793	151,397	5,607	157,005	—	157,005
その他の収益	—	—	—	—	—	—	—
外部顧客への売上高	95,604	55,793	151,397	5,607	157,005	—	157,005
セグメント間の内部 売上高または振替高	—	181	181	2,737	2,918	△2,918	—
計	95,604	55,974	151,578	8,345	159,923	△2,918	157,005
セグメント利益	34,285	20,199	54,485	2,018	56,503	△1,853	54,649

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に連結子会社の事業によるものであります。

2. セグメント利益の調整額△1,853百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

当第2四半期連結累計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）

報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報ならびに収益の分解情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 3
	プラスチック パッケージ	メタル パッケージ	計				
売上高							
一時点で移転される財	65,406	35,406	100,812	4,296	105,109	—	105,109
一定の期間にわたり移 転される財	—	—	—	—	—	—	—
I Cリードフレーム	—	16,766	16,766	2,633	19,399	—	19,399
I Cパッケージ	65,406	3,129	68,535	152	68,688	—	68,688
気密部品	—	15,510	15,510	1,510	17,021	—	17,021
その他	—	—	—	0	0	—	0
顧客との契約から生じ る収益	65,406	35,406	100,812	4,296	105,109	—	105,109
その他の収益	—	—	—	—	—	—	—
外部顧客への売上高	65,406	35,406	100,812	4,296	105,109	—	105,109
セグメント間の内部 売上高または振替高	—	189	189	1,806	1,995	△1,995	—
計	65,406	35,595	101,001	6,103	107,105	△1,995	105,109
セグメント利益	7,148	7,974	15,122	489	15,612	△1,539	14,073

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に連結子会社の事業によるものであります。

2. セグメント利益の調整額△1,539百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

参考資料



2023年10月26日
新光電気工業株式会社

2024年3月期 第2四半期 決算概要 (連結)

1. 業績等の概況

(単位：百万円)

	2023年3月期 第2四半期 (2022年4月1日から 2022年9月30日まで)	2024年3月期 第2四半期 (2023年4月1日から 2023年9月30日まで)	前年同期比 増減率 (%)	2023年3月期 (2022年4月1日から 2023年3月31日まで)
売上高	157,005	105,109	△33.1	286,358
営業利益	50,952	11,470	△77.5	76,712
経常利益	54,649	14,073	△74.2	78,755
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	37,873	9,780	△74.2	54,488
1株当たり四半期 (当期)純利益	280円34銭	72円39銭		403円32銭
総資産	376,092	389,575		386,934
純資産	237,545	258,541		251,014
自己資本比率	63.2%	66.4%		64.9%
設備投資額*	15,823	21,489		25,758
減価償却費*	16,125	12,820		34,511
研究開発費	1,793	1,688		3,580
為替レート(1米ドル)	132円	139円		134円

* 無形固定資産を除く

2. セグメント情報

(単位：百万円)

セグメント		2023年3月期 第2四半期 (2022年4月1日から 2022年9月30日まで)	2024年3月期 第2四半期 (2023年4月1日から 2023年9月30日まで)	前年同期比 増減率 (%)	2023年3月期 (2022年4月1日から 2023年3月31日まで)
売上高 *1	プラスチックパッケージ	95,604 (60.9)	65,406 (62.2)	△31.6	176,844 (61.7)
	メタルパッケージ	55,793 (35.5)	35,406 (33.7)	△36.5	99,284 (34.7)
	その他	5,607 (3.6)	4,296 (4.1)	△23.4	10,229 (3.6)
	合計	157,005 (100.0)	105,109 (100.0)	△33.1	286,358 (100.0)
経常利益 *2	プラスチックパッケージ	34,285 (35.9)	7,148 (10.9)	△79.2	47,331 (26.8)
	メタルパッケージ	20,199 (36.2)	7,974 (22.5)	△60.5	31,224 (31.4)
	その他/調整額	164	△1,049		198
	合計	54,649 (34.8)	14,073 (13.4)	△74.2	78,755 (27.5)

*1 外部顧客への売上高

*2 セグメント間取引調整前の経常利益

3. 部門別売上高

(単位：百万円)

部 門	2023年3月期 第2四半期 (2022年4月1日から 2022年9月30日まで)		2024年3月期 第2四半期 (2023年4月1日から 2023年9月30日まで)		前年同期比 増減率 (%)	2023年3月期 (2022年4月1日から 2023年3月31日まで)	
		構成比(%)		構成比(%)			構成比(%)
ICリードフレーム	28,522	(18.2)	19,399	(18.5)	△32.0	49,659	(17.4)
ICパッケージ	103,391	(65.8)	68,688	(65.3)	△33.6	187,938	(65.6)
気密部品	25,078	(16.0)	17,021	(16.2)	△32.1	48,744	(17.0)
その他	12	(0.0)	0	(0.0)	△98.1	15	(0.0)
合 計	157,005	(100.0)	105,109	(100.0)	△33.1	286,358	(100.0)